

適用規格					
定 格	使用温度範囲	−55℃ ~ +85℃ ^{(1) (2)}	保存温度範囲	−10℃ ~ +60℃ ⁽³⁾	
	使用湿度範囲	相対湿度90%以下 ^{(2) (4)}	保存湿度範囲	相対湿度70%以下 ^{(3) (4)}	
	電 圧	DC/AC 300V			
	電 流	60A（温度上昇値30℃以内）			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗 [EIA-364-23]	100mAで測定する。	2mΩ 以下 ※導体抵抗含む。 嵌合相手: IT-PM-2S-DIR, IT-PD-2S-DIR	○	—
	絶縁抵抗 [EIA-364-21]	DC500Vで測定する。	1000MΩ 以上	○	—
	耐電圧 [EIA-364-20]	AC1000Vの電圧を1分間印加する。 (漏洩電流2mA以下)	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機 械 的 性 能	総合挿抜力 [EIA-364-13]	適合コネクタで測定する。	1) 挿入力: 50N 以下 2) 抜去力: 3N 以上	○	—
	繰り返し動作 [EIA-364-09]	100回の抜き差しを行う。	1) 接触抵抗: 2mΩ 以下 ※導体抵抗含む。 2) 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性 [EIA-364-28]	周波数50 ~ 2000 Hz, 加速度スペクトル密度 0.1g ² /Hz, 3軸方向各90分試験する。 ※試験サンプルは、コネクタ以外の支柱にて 上下の基板固定する	1) 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 2) 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性 [EIA-364-27]	加速度490m/s ² , 持続時間11ms, 3軸方向各3回 試験する。 ※試験サンプルは、コネクタ以外の支柱にて 上下の基板固定する。		○	—
環 境 的 性 能	熱衝撃 [EIA-364-32]	温度(℃) −55→20~35→85→20~35 時間(分) 30→ 5MAX →30→ 5MAX を10サイクル試験する。	1) 接触抵抗: 2mΩ 以下 ※導体抵抗含む。 2) 絶縁抵抗: 100MΩ 以上 3) 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	温湿度サイクル [EIA-364-31]	温度25℃, 相対湿度80%: 60分 ↓ 30分 温度65℃, 相対湿度50%: 60分 を24サイクル試験する。		○	—
	耐熱性 [EIA-364-17]	温度105℃中に120時間放置する。	1) 接触抵抗: 2mΩ 以下 ※導体抵抗含む。 2) 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	4種混合ガス [EIA-364-65]	温度30℃, 相対湿度70% Cl ₂ : 10ppb, NO ₂ : 200ppb, H ₂ S: 10ppb, SO ₂ : 100ppb 未嵌合放置7日間 → 嵌合放置7日間	1) 接触抵抗: 2mΩ 以下 ※導体抵抗含む。 2) 機能を損なう様な腐食等の異常がない こと。	○	—

性能		試験方法		規格		QT	AT
項目							
【参 考】ディレーティングカーブと温度上昇曲線							
軽減曲線(ディレーティングカーブ) 温度上昇曲線 <測定基板条件> ・サイズ：D80×W68×t3.7mm （9層基板） ・材質：FR-4 ・構成：下図参照 L1_TOP L2_PLN L3_PLN L4_PLN L5_PLN L6_PLN L7_PLN L8_PLN L9_BOT 3.7 -0.05 +0.05 SOLDER LEVEL COPPER PLATE COPPER FOIL PREPREG COPPER FOIL CORE COPPER FOIL PREPREG COPPER FOIL CORE COPPER FOIL PREPREG COPPER FOIL COPPER PLATE SOLDER LEVEL 0.053 MM 0.035 MM 0.035 MM 0.035 MM 0.035 MM 0.035 MM 0.035 MM 0.035 MM 0.035 MM 0.035 MM 0.035 MM 0.035 MM 0.035 MM 0.053 MM							
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目				図番		SLC4-339735-01	
製品規格表 ヒロセ電機株式会社				製品名		IT-P-2P-35H(11)	
				製品コード		CL636-0602-2-11	
						2/2	